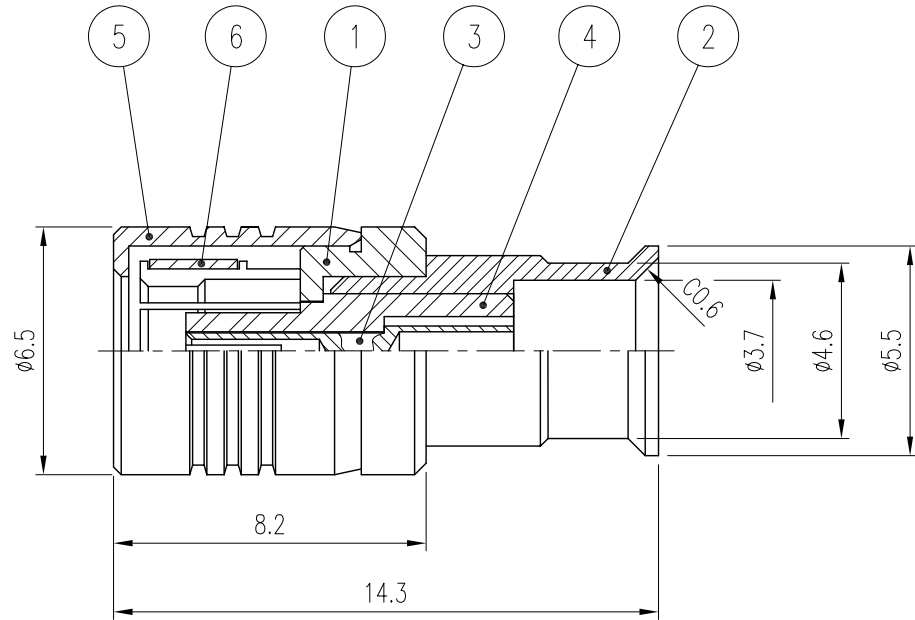


수 정 내 용									
ST	가공								
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일					
△1	조립난이도에 의한 설계변경	최충락	김기영	2000. 8. 4.					
△									



3	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00004-5/1 (R3001)
2	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00021-5/1 (K3001)
1	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00343-N/1 (H3010)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00351-5/1 (E3006)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00488-5/1 (D3009)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00433-5/1 (D3001)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .*.* ±0.05	년월일	1995. 4. 4.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
재질 _____	검도				도명	SMB-PS-141 VER.0	
	재도						
열처리 _____	작성부서		연 구 소				
보호파막처리 _____	척도 4/1	단위 mm	중량 _____				
					A4	도번	CN00182-7/1
						K315-093-000	